

EPOXY 4089

CARACTERÍSTICAS

- Desarrollado para aplicaciones de dispensado
- Formula no forma hilos durante su aplicación
- Para aplicaciones de uso pesado
- Adhesivo epoxi de una sola pieza
- Alta resistencia mecánica al desprendimiento
- Cumple con la directiva RoHS

DESCRIPCIÓN

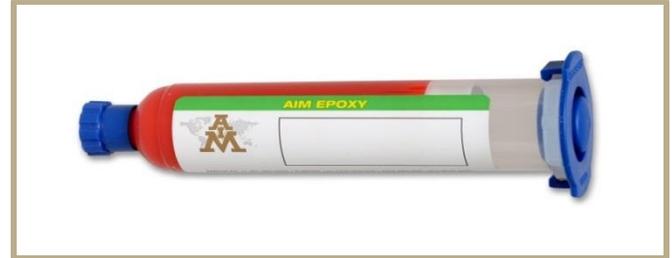
El Epoxy 4089 es un adhesivo tipo epoxi de una sola pieza usado para unir componentes SMT a una PCB antes del reflujo doble cara o del proceso de soldadura por ola. El Epoxy 4089 ha sido formulado para su uso en todo tipo de equipos de dispensado de alta velocidad, incluyendo presión de aire, válvula de tornillo sinfin, pistón y tubo de presión. El Epoxy 4089 no forma hilos y provee depositos de adhesivo con forma, tamaño y volumen consistentes. El Epoxy 4089 tiene un tiempo de vida prolongado, hasta 6 meses sin refrigeración, eliminando muchos de los problemas de manejo asociados a otros adhesivos de tipo epoxi para componentes chip. El Epoxy 4089 tiene la fuerza de adhesión necesaria para su uso con equipos de dispensado de alta velocidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

Parámetro	Resultado
Visual	Líquido espeso
Olor	Aromático (ligeramente)
Color	Rojo
Viscosidad	300-500 kcps
Punto de ebullición	> 260°C (500°F)

PROPIEDADES MECÁNICAS

Parámetro	Resultado
Punto de deflexión de calor	97°C (207°F)
Resistencia a la tracción	11,500 psi Típico
Elongación %	4.6 Typical
Módulo de tracción	4.9 psi x 10 ⁵ Típico
Resistencia de torque	45 N.mm +/- 15 Típico



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil (no refrigerada)	6 meses	< 25°C (77°F)

No almacene cerca del fuego. Debe mantenerse alejado de la luz solar, ya que esta puede degradar el producto. No mezcle adhesivo nuevo con adhesivo usado en el mismo recipiente. Si el material se endurece o cristaliza, puede recalentarse a 40°C (104°F) durante 8 horas, hasta que esté en condiciones de uso.

APLICACIÓN

El Epoxy 4089 se entrega listo para usar en jeringas tipo EFD al vacío, en presentaciones de 10cc y 30cc. También está disponible en empaque Fuji e Iwashita. La calidad de dispensado del adhesivo depende de la presión de dispensado, tiempo, tamaño de la boquilla, y la temperatura. La resistencia de la unión dependerá del tipo de componente, tamaño del depósito de adhesivo, curado y tipo de máscara de soldadura.

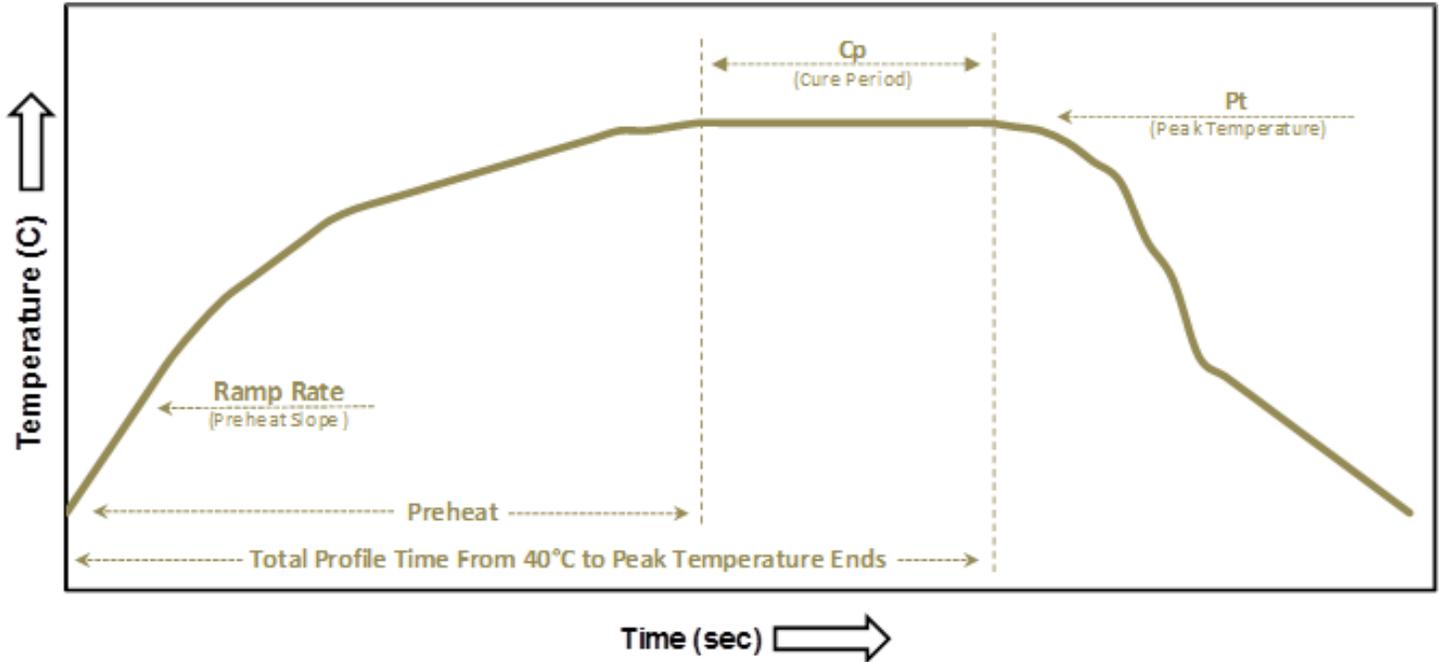
LIMPIEZA

El adhesivo sin curado puede ser removido de la PCB con alcohol isopropílico. La remoción de epoxi curado o de componentes adheridos puede ser realizada mediante la aplicación de calor a 120°C (250°F).

SEGURIDAD

Usar en una área con ventilación y equipo de protección personal adecuado. Para información de emergencia, consulte la SDS correspondiente. Disponga de cualquier material peligroso en contenedores autorizados.

PERFIL DE CURADO RECOMENDADO



Características del perfil	Parámetro
Rampa de calentamiento	1°C-2.5°C/Segundos
Precalentar desde 40°C to 100°C	40-80 Segundos
Precalentar desde 100°C to 120°C	50-70 Segundos
Temperatura máxima (Tp)	120°C-125°C
Tiempo de exposición a temperatura máxima	60 Segundos
Tiempo total del perfil	2.5-3.5 Minutos

*La información que se proporciona sobre perfiles debe ser empleada solo como referencia. Su perfil puede diferir debido a variables de proceso y de materiales.